

第 **85** 期

# 上半期報告書

(平成 30 年 2 月 1 日～平成 30 年 7 月 31 日)

～省資源・省エネは子孫へ贈る最大の贈り物～



株式会社 **三井ハイテック**

# 会社概要 (平成30年7月31日現在)

商号	株式会社三井ハイテック
英文名称	Mitsui High-tec, Inc.
設立年月日	昭和9年7月3日 (当社の実体は昭和24年1月12日創業)
資本金	16,403,883,263円
従業員数	2,070名 (平成30年7月31日現在)
本社	北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号 (〒807-8588) 電話 (093) 614-1111 (代表)
支社	●東京支社 東京都港区三田三丁目13番16号
事業所	●八幡事業所 北九州市八幡西区小嶺二丁目10番1号 ●金型事業所 北九州市八幡西区大字野面864番地の8 ●直方事業所 福岡県直方市中泉965番地の1 ●黍田事業所 福岡県直方市大字下境410番10 ●熊本事業所 熊本県菊池郡大津町大字高尾野272番地15 ●阿蘇事業所 熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子312番地8 ●岐阜事業所 岐阜県可児市柿田字馬乗洞675番35
営業所	●大阪営業所 大阪市淀川区西中島六丁目1番1号 ●名古屋営業所 名古屋市中村区名駅四丁目4番10号 ●東北営業所 仙台市青葉区本町二丁目10番33号 ●豊田営業所 愛知県豊田市山之手五丁目121番地
主要製品	プレス用精密金型・その他の各種部品用精密金型 リードフレーム・平面研削盤 モーターコア・その他プレス打抜加工製品他
子会社	Mitsui High-tec (Singapore) Pte. Ltd. Mitsui High-tec (Hong Kong), Ltd. Mitsui High-tec (USA), Inc. Mitsui High-tec (Malaysia) Sdn. Bhd. 三井高科技 (天津) 有限公司 三井高科技 (上海) 有限公司 Mitsui Asia Headquarters Pte. Ltd. MHT America Holdings, Inc. Mitsui High-tec (Taiwan) Co., Ltd. Mitsui High-tec (Thailand) Co., Ltd. 三井高科技 (広東) 有限公司 株式会社三井スタンピング Mitsui High-tec (Canada), Inc. Mitsui High-tec (Europe) sp.z o.o.

(平成30年10月設立予定)

# 株主の皆様へ

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて当社は平成30年7月31日をもって第85期上半期（平成30年2月1日から平成30年7月31日まで）の決算を行いましたので事業の概況等をご報告申し上げます。

敬具

## (1) 経営の基本方針

当社グループは創業以来、「世界の人々に役立つ製品をつくる」、「互惠互善の理念に徹し相互の利益をはかる」、「平等の精神を基本とし働く者の楽園を築く」という社是を経営理念として、事業活動を通じ、社会・地球環境との調和を図り、持続可能な社会の発展に貢献することを基本方針としております。

## (2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主還元を経営の重点課題と認識しており、利益配分については連結配当性向30%を目処に、業績を勘案した配当を行うことを基本方針としております。また、新製品開発や競争力強化のための設備投資等に有効活用することを目的に、内部留保の充実を図って参ります。

## (3) 中長期的な経営戦略

当社グループは創業以来、「技術開発指向型」企業として、「不可能を可能」にした開発を種々行い、それぞれの時代に合ったお客様のニーズに応えて参りました。

近年、環境問題への取り組みの必要性が増大しているなか、当社グループとしましては、「省資源・省エネは子孫へ贈る最大の贈り物」というスローガンのもと、超精密加工技術をベースに環境対応技術に貢献する製品・部品の供給拡大を図り、世界経済の発展に貢献して参ります。

さらにグローバルに展開している海外拠点を武器に「消費地立地」を活かしたサービスと製品提供を行

い、お客様のニーズに応じて参ります。

そのなかで、安定的な収益確保と財政基盤の充実を図るため、各事業や各拠点が連携し、全体最適による経営資源の効率的活用に努めて参ります。

## (4) 経営成績

### ① 当上半期の概況

当上半期における我が国経済は、企業収益及び雇用・所得環境の改善傾向が続くなか、個人消費が比較的順調に推移し、総じて緩やかな景気回復が続きました。

米国経済は堅調な雇用情勢を背景に経済成長が持続しており、欧州経済も政治情勢に対する懸念は残るものの底堅い成長が続いております。また、中国経済においては景気の減速が見られますが、安定的な成長を維持しております。

そのなかで、当社グループの主たる供給先である半導体業界においては、車載向け半導体の需要は堅調に推移した半面、スマートフォン等の携帯用端末向け半導体は在庫調整が継続しております。一方、自動車業界においては、ハイブリッド車、電気自動車が堅調に推移しました。なお、為替相場は前年同期比3円21銭円高の108円77銭/米ドルで推移しました。

このような事業環境のもと、当社グループは、省資源・省エネルギーに貢献する製品・部品の受注拡大、グローバルな新規顧客の開拓及び全グループを挙げて生産性向上と原価低減に取り組みました。

また、将来の市場拡大に伴う受注拡大を見据え、成長分野への積極的な投資を実施しました。

その結果、当上半期の売上高は414億2千6百万円（前年同期比9.1%増）となりました。一方、スマートフォン等の携帯用端末向け半導体の在庫調整による電子部品事業の稼働率低下及び減価償却費が前年同期比4億8千5百万円増の28億9千3百万円（前年同期24億8百万円）に増えるなどの営業費用の増加ならびに前年同期比で円高となった影響もあり、営業利益は6

億9千1百万円（前年同期比45.3%減）となりました。

経常利益は当上半期で2億2千9百万円の為替差益を計上したことなどにより、9億7千8百万円（前年同期比19.1%減）となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益として設備投資に関する補助金収入1億7千4百万円を計上しましたが、8億8百万円（前年同期比50.8%減）となりました。なお、前年同期は、税効果会計の新たな適用指針に基づき法人税等調整額△6億8千5百万円（△は益）を計上しております。

## ② セグメント概要

### （金型）

金型事業については、超精密加工技術の追求により、省資源化・省エネ化などをはじめとしたお客様のニーズに対応しました。その結果、売上高は37億7千9百万円（前年同期比2.2%増）、営業利益は4億6千2百万円（前年同期比34.1%増）となりました。

### （電子部品）

電子部品事業については、車載向け半導体の受注が堅調に推移した結果、売上高は222億4千4百万円（前年同期比8.3%増）となりました。しかし、今後需要の拡大が予想されるスマートフォン等の携帯用端末向けや車載向けリードフレームの生産能力増強により営業費用が増加したなか、スマートフォン等の携帯用端末向け半導体の在庫調整が継続しており、生産能力を満たすことができませんでした。さらに、為替相場が円高に推移したことも影響し、営業利益は1億2千万円（前年同期比85.6%減）となりました。

### （電機部品）

電機部品事業については、試作から量産までの一貫体制を活かし、車載及び産業・家電用のモーターコアの拡販活動と生産性向上に取り組みました。その結果、売上高は164億1千5百万円（前年同期比12.1%増）、営業利益は14億5百万円（前年同期比29.1%増）となりました。なお、将来の市場と受注拡大を見

据えた取り組みにおいて、海外ではカナダ子会社が7月より量産開始しており、国内では岐阜事業所は当初の予定どおり2019年2月の量産開始となっております。

(工作機械)

工作機械事業については、電子部品向け市場や自動車向け市場を中心に拡販活動を実施しました。その結果、売上高は9億2千5百万円（前年同期比31.5%増）、営業利益は生産性向上と原価低減も寄与し、8千5百万円（前年同期は営業損失3千5百万円）となりました。

なお、上記セグメント売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高19億3千9百万円を含めて表示しております。

中間配当につきましては1株につき4円とさせていただきます。

## (5) 通期の見通し

当社グループを取り巻く事業環境は、米国政権の保護主義的な通商政策やそれに端を発する貿易摩擦のリスクの高まりなどによる世界経済の先行きが見えないリスク、新興国市場の台頭による低価格品への需要シフト、環境対応ニーズの加速、業界再編などにより大きく変化すると予想されます。

そのなかにあって、当社グループは、超精密加工技術をベースに環境対応技術の普及に貢献する製品・部品の供給拡大と生産性向上に取り組んで参ります。また、金型製作から製品供給までの一貫生産の強みを活かし、他社との差別化を図って参ります。

事業環境を分析してその変化に対応し、健全な企業体質を構築するために各事業やロケーションの特徴・機能を含め相乗効果が発揮できるよう連携して取り組みます。

今後も超精密加工技術を核として、グローバル供給体制を活かし顧客ニーズに対応するとともに、引き続き生産性向上、歩留り向上に取り組む収益拡大

を図ります。

通期の業績予想について、金型事業、電機部品事業及び工作機械事業の売上高は概ね当初予想通りに推移する見通しですが、電子部品事業において、スマートフォン等の携帯用端末向け半導体の在庫調整などの影響により、リードフレームの販売が計画に対して減少することが見込まれます。

また、売上高の減少見込み20億円に対し営業費用の削減を5億円見込みますが付加価値の減少12億円は補えず、営業利益、経常利益、当期純利益につきましても、当初予想を下回る見通しとなりました。

その結果、通期の業績予想を見直し、売上高は870億円を850億円、営業利益は15億円を8億円、経常利益は15億円を10億円、当期純利益は10億円を7億円に修正いたしました。為替相場は引き続き、1ドル110円を想定しております。

なお、期末配当予想につきましては、当期純利益が当初予想を下回るが見込まれることから、1株当たり4円を1株当たり2円に修正させていただきました。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成30年10月

代表取締役社長

三井康誠



# 連結貸借対照表

(単位：百万円)

資 産 の 部			
	前上半期連結会計 期間末 (平成29年7月31日)	当上半期連結会計 期間末 (平成30年7月31日)	前連結会計 年度末 (平成30年1月31日)
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>40,281</b>	<b>42,725</b>	<b>37,540</b>
現金及び預金	16,199	16,086	12,837
受取手形及び売掛金	12,262	12,569	12,312
電子記録債権	1,949	2,005	2,218
有価証券	2,300	2,800	1,500
たな卸資産	6,249	7,559	6,770
繰延税金資産	250	145	202
その他	1,082	1,571	1,712
貸倒引当金	△13	△13	△14
<b>固 定 資 産</b>	<b>30,733</b>	<b>36,115</b>	<b>34,758</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>27,843</b>	<b>33,262</b>	<b>31,900</b>
建物及び構築物	7,727	8,734	8,809
機械装置及び運搬具	10,493	12,091	11,739
工具、器具及び備品	2,258	2,326	2,400
土地	6,182	7,567	7,374
建設仮勘定	1,181	2,542	1,577
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>403</b>	<b>369</b>	<b>381</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,485</b>	<b>2,483</b>	<b>2,476</b>
投資有価証券	905	1,015	1,061
繰延税金資産	543	358	380
退職給付に係る資産	314	290	256
その他	721	818	777
<b>資 産 合 計</b>	<b>71,015</b>	<b>78,840</b>	<b>72,298</b>



(単位：百万円)

負 債 の 部			
	前上半期連結会計 期間末 (平成29年7月31日)	当上半期連結会計 期間末 (平成30年7月31日)	前連結会計 年度末 (平成30年1月31日)
区 分	金 額	金 額	金 額
<b>流 動 負 債</b>	<b>9,418</b>	<b>10,379</b>	<b>10,865</b>
買 掛 金	4,982	5,425	4,670
一年内返済予定長期借入金	1,200	1,649	1,387
未払法人税等	340	365	455
役員賞与引当金	33	15	59
そ の 他	2,862	2,923	4,293
<b>固 定 負 債</b>	<b>11,668</b>	<b>18,438</b>	<b>10,938</b>
長 期 借 入 金	11,331	18,097	10,606
役員退職慰労引当金	149	171	159
事業整理損失引当金	174	133	134
退職給付に係る負債	13	36	37
<b>負 債 合 計</b>	<b>21,086</b>	<b>28,818</b>	<b>21,804</b>
純 資 産 の 部			
<b>株 主 資 本 金</b>	<b>50,390</b>	<b>50,287</b>	<b>50,420</b>
資 本 金	16,403	16,403	16,403
資 本 剰 余 金	17,252	17,252	17,252
利 益 剰 余 金	19,809	20,265	19,840
自 己 株 式	△3,074	△3,634	△3,076
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>△625</b>	<b>△452</b>	<b>△105</b>
その他有価証券評価差額金	312	384	418
為替換算調整勘定	△978	△818	△493
退職給付に係る調整累計額	40	△18	△30
<b>非支配株主持分</b>	<b>163</b>	<b>187</b>	<b>179</b>
<b>純 資 産 合 計</b>	<b>49,928</b>	<b>50,022</b>	<b>50,494</b>
<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>71,015</b>	<b>78,840</b>	<b>72,298</b>

# 連結損益計算書

(単位：百万円)

	前上半期連結 会計期間 (自平成29年2月1日 至平成29年7月31日)	当上半期連結 会計期間 (自平成30年2月1日 至平成30年7月31日)	前連結 会計年度 (自平成29年2月1日 至平成30年1月31日)
区 分	金 額	金 額	金 額
売 上 高	37,955	41,426	78,727
売 上 原 価	32,449	36,237	67,994
売 上 総 利 益	5,506	5,189	10,733
販売費及び一般管理費	4,241	4,498	8,591
営 業 利 益	1,264	691	2,142
営 業 外 収 益	93	345	193
受 取 利 息	29	41	59
為 替 差 益	—	229	—
そ の 他	64	74	133
営 業 外 費 用	148	59	480
支 払 利 息	10	23	23
為 替 差 損	82	—	278
固 定 資 産 除 売 却 損	50	18	160
そ の 他	4	17	17
経 常 利 益	1,209	978	1,856
特 別 利 益	—	174	63
補 助 金 収 入	—	174	63
特 別 損 失	—	—	52
減 損 損 失	—	—	17
固 定 資 産 圧 縮 損	—	—	34
税金等調整前上半期純利益	1,209	1,152	1,866
法 人 税 等	△451	329	△76
四半期(当期)純利益	1,661	823	1,943
非支配株主に帰属する 四半期(当期)純利益	16	14	36
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	1,644	808	1,906

# 役

# 員 (平成 30 年 7 月 31 日現在)

代表取締役社長	三井康誠
専務取締役	丸岡好雄
常務取締役	栗山正則
常務取締役	石松憲治
取締役	辻本圭一
取締役	白川裕之
取締役	草野敏昭
取締役	坂上隆紀
取締役	鈴木豊
取締役	熊丸邦明
常勤監査役	中島輝久
常勤監査役	藤嶋省二
監査役	近藤真
監査役	鈴木良樹

- (注) 1. 取締役 鈴木 豊氏及び熊丸邦明氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役 近藤 真氏及び鈴木良樹氏は、社外監査役であります。



**Mitsui  
High-tec  
Inc.**

株式会社 **三井ハイテック**

## 株主メモ

事業年度	毎年2月1日から翌年1月31日まで
定時株主総会	毎年4月
剰余金の配当の基準日	期末配当金 毎年1月31日 中間配当金 毎年7月31日
公告方法	電子公告 ホームページ <a href="https://www.mitsui-high-tec.com/">https://www.mitsui-high-tec.com/</a> ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
1単元の株式の数	100株
上場証券取引所	東京（市場第一部）・福岡
株主名簿管理人	東京証券代行株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
郵便物送付先 連絡先	〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 東京証券代行株式会社 事務センター (お問い合わせ先) ☎ 0120-49-7009 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の 全国本支店で行っております。
株式に関する各種手続 の申出先について	<ul style="list-style-type: none"><li>住所変更、単元未満株式の買取請求、配当金受取方法の指定等は、お取引口座のある証券会社にお申し出ください。ただし、特別口座に記録された株式に係る各種手続につきましては、特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会社にお申し出ください。</li><li>未支払配当金のお支払につきましては、株主名簿管理人である東京証券代行株式会社にお申し出ください。</li></ul>